

勤凱科技股份有限公司

2026/Q4

免 責 聲 明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容，乃是建立在本公司從內部與外部來源所取得的資訊基礎。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時， 本公司並不負責隨時提醒或更新。

公 司 基 本 資 料



- 資　本　額：NT$ 3.28億
- 籌資活動：2026/05/22　發行 4E CB

  轉換價 **297.6**　預計股本膨脹 4%
- 主要產品：

◆先進封裝散熱、接著材料
◆軟板填孔導電材料
◆被動元件導電材料

- 公司地址：高雄市大發工業區大有三街32號

2025年《天下》兩千大營運績效50強

2025年《天下》兩千大營運績效50強

天下雜誌 CommonWealth Magazine

排名	公司名稱	'22年～'24年營收成長率(%)	得分	'22年～'24年稅後純益成長率(%)	得分	2024年股東權益報酬率(%)	得分	2024年營收成長率(%)	得分	2024年稅後純益成長率(%)	得分	'22年～'24年稅後純益總和(億元)	得分	總分	主要產品
1	濟南大自然新材料	91.85	20	158.27	19	50.84	20	42.51	19	61.09	16	147.64	19	113	香菸濾嘴用醋酸纖維絲束
2	華城電機	61.45	19	126.15	19	48.85	20	45.35	19	66.32	17	77.01	18	112	配電及電力變壓器等設備
3	名軒開發	109.63	20	101.97	18	30.75	19	68.14	19	52.47	16	49.94	17	109	住宅或商業大樓興建、租售
4	世芯電子	94.59	20	87.48	18	16.33	11	70.49	19	93.86	19	116.05	19	106	特殊應用積體電路設計製造
4	富宇地產	336.52	20	702.84	20	27.95	18	84.33	20	168.56	20	9.84	8	106	住宅或商業大樓興建、租售
6	台光電子材料	29.02	18	37.41	13	27.29	18	55.89	19	74.53	18	201.39	19	105	銅箔基板、黏合片等
6	新潤興業	91.29	20	72.32	17	25.10	17	149.25	20	117.71	19	17.44	12	105	住宅及大樓興建、租售
8	昇益開發	145.76	20	152.32	19	33.16	19	124.26	20	130.12	19	6.08	6	103	住宅及大樓興建、租售
8	皇普建設	75.59	20	133.62	19	18.29	12	188.16	20	436.78	20	17.79	12	103	住宅或商業大樓興建、租售
40	潤德室內裝修設計工程	37.34	18	47.47	15	25.28	17	31.73	17	51.35	15	4.75	4	86	設計與裝修工程
43	中台資源科技	43.14	19	50.74	15	14.95	9	34.98	18	60.39	16	8.44	8	85	廢棄物資源化處理
43	勤凱科技	26.80	17	43.71	14	20.54	14	42.78	19	62.39	17	3.99	4	85	被動元件導電漿
45	力麗科技	52.30	19	29.38	11	22.34	15	99.78	20	35.88	14	5.39	5	84	IoT應用平台暨解決方案
46	肯微科技	24.02	16	36.52	13	9.89	5	32.04	18	78.57	18	21.49	13	83	伺服器電源供應器
46	信鼎技術服務	12.82	11	26.79	10	43.13	20	17.52	14	52.95	16	16.50	12	83	廢棄物資源化處理

2025年營運績效50強調查方法：將過去3年（2022～2024）每年營收、獲利皆持續成長的製造業與服務業，依長期成長、單年表現及企業規模等6項指標評估企業的營運績效。符合上述條件的企業，分別在每項指標中，依數值高低分成20等份，再依據相對位置給予1到20分。最後，將6項指標的得分加總，以總分排名。名次相同者，依公司名稱筆劃排序。

產業說明

項目	原材料/設備			備註
CCL	銅箔	玻璃纖維布	樹酯	M7/M8/M9/M10
半導體封裝	晶圓	導線架	?	只談導線架三雄
TGV	玻璃	雷射穿孔	?	填孔材料?
MLCC 電容	?	?	?	村田/台灣 差異>>材料

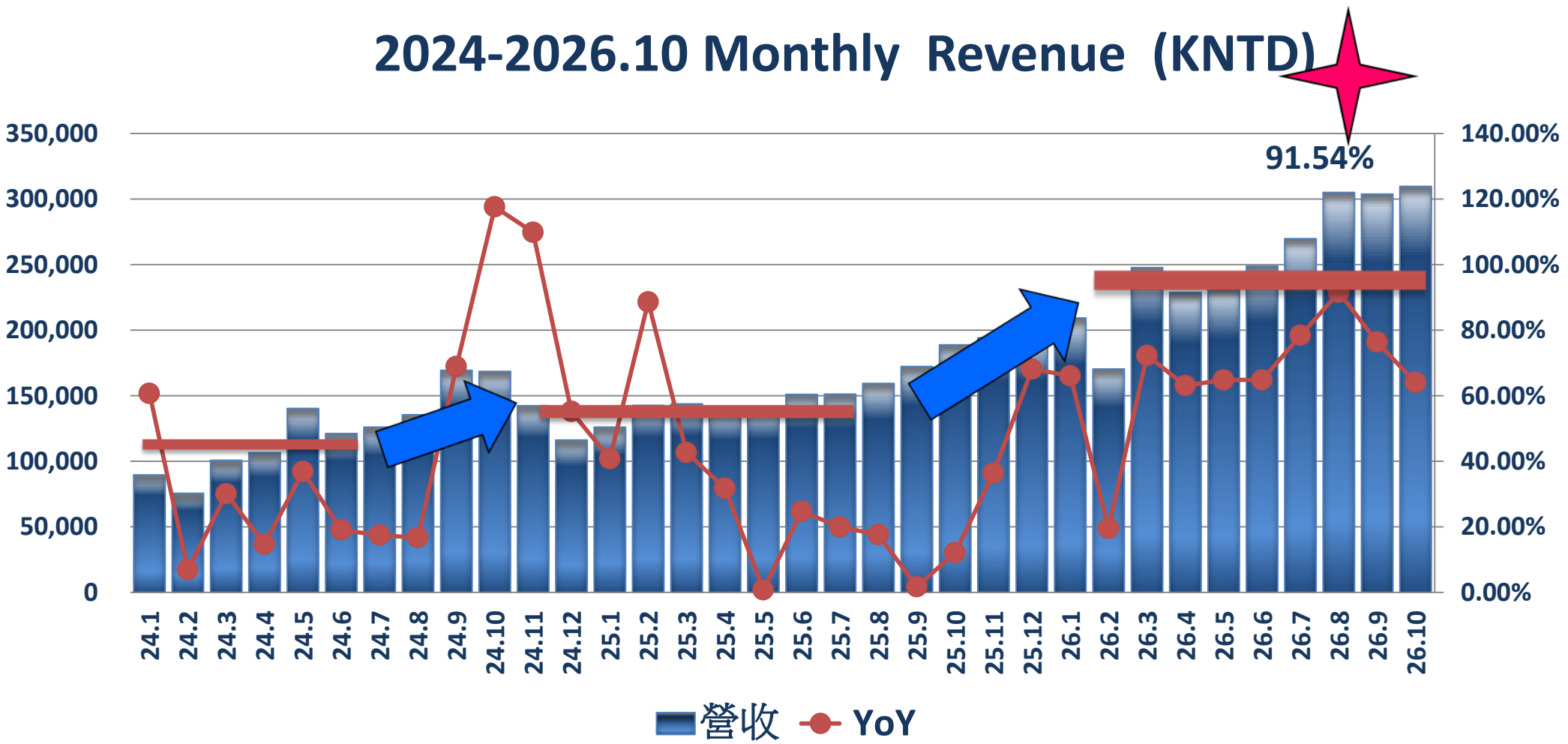
- 導電漿料是關鍵直接材料 但仍大量仰賴進口 進入門檻極高
- 業內技術人員才知其重要性,影響品質的關鍵因子,不敢輕易更動
- 資本市場無同比公司形成族群,足以證明其稀缺性及獨特性
- 國內缺少此產業研究報告 資本市場對此產業極為陌生

MLCC 高容 中低容?


MLCC（積層陶瓷電容）製造流程解說
看不見的精密 成就更好的連接
01 原料調配
（氧化鋁 / 磁料）
調配出均勻漿料
02 塗膜成型
（流延）
將陶瓷漿料塗佈成薄膜
03 電極印刷
（印刷）
在薄膜上印刷內部電極
04 晶片堆疊
（疊層）
依序堆疊成多層結構
05
（層壓 / 均壓）
去除氣泡、提高密度
06 晶片切割
（切割）
07
（排膠）
去除內部有機結合劑
08 高溫燒結
（燒結）
在高溫下燒結形成陶瓷結構
09 研磨倒角
（倒角）
晶片磨底料、磨圓邊角
10 外部端接
（沾銀 / 點接）
晶片兩端浸入金屬漿料
11 端極燒附
（燒附）
使端電極與陶瓷穩固結合
12 表面電鍍
（電鍍）
晶片鍍、鍍電鍍
13 量測分選
（測試 / 分選）
電容測試並分選等級
14
（編帶）
合格品裝入打孔紙帶
15 成品出貨!
（包裝）
完成之多層陶瓷電容器(MLCC)
高品質 MLCC
為您的產品注入穩定能量
高可靠性
高精度
多元尺寸


導電漿產業
長期被日本美國壟斷
導電漿產業
日本・美國
長期壟斷
半導體封裝
高階PCB
MLCC
散熱材料

月營收


2024-2026.10 Monthly Revenue (KNTD)
91.54%
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
140.00%
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
24.10
24.11
24.12
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
25.8
25.9
25.10
25.11
25.12
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7
26.8
26.9
26.10
營收
YoY

2026 Q1/Q2/Q3 續創歷史高 Q4 ?

NT$ 千元	2022	2023	2024	2025	2026.Q1	2026.Q2	2026.Q3
營業收人	928,090	1,045,002	1,491,879	1,906,400	627,462	710,778	878,644
營業毛利	194,267	224,069	326,055	410,118	123,851	129,588	180,910
毛利率(%)	21%	21%	22%	22%	20%	18%	21%
營業費用	(89,559)	(95,247)	(104,018)	(121,941)	(34,682)	(32,738)	(38,785)
營業費用率(%)	9%	9%	9%	6%	6%	4%	5%
營業淨利	104,708	128,822	222,037	288,177	89,169	96,850	142,125
營業淨利率(%)	12%	12%	15%	16%	14%	14%	16%
營業外收支淨額	11,709	14,345	15,758	(9,720)	9,965	9,589	(3,177)
稅前淨利	116,417	143,167	237,795	278,457	99,134	106,439	138,948
所得稅費用	(24,059)	(26,443)	(48,028)	(55,530)	(18,448)	(20,784)	(27,896)
本期淨利	92,358	116,724	189,767	222,927	80,686	85,655	111,052
淨利率(%)	10%	11%	13%	12%	13%	12%	13%
每股盈餘(元)	3.08	3.9	6.3	7.05	2.55	2.71	3.44
折舊費用	24,873	23,682	23,271	22,590	5,258	5,161	5,170
資本支出	12,419	13,020	12,489	9,427	937	103,938	4,511

股利政策

年度	2020	2021	2022	2023	2024	2025
每股盈餘	4.74	6.7	3.08	3.9	6.3	7.05
現金股利	3.2	4.5	2.2	2.7	3.7	4.5
股票股利	–	–	–	–	0.5	0.2
配發股利合計	3.2	4.5	2.2	2.7	4.2	4.7
配息率	67.5%	67.2%	71.4%	69.2%	66.7%	66.7%

自公發起算 連續13年配發股利 ！

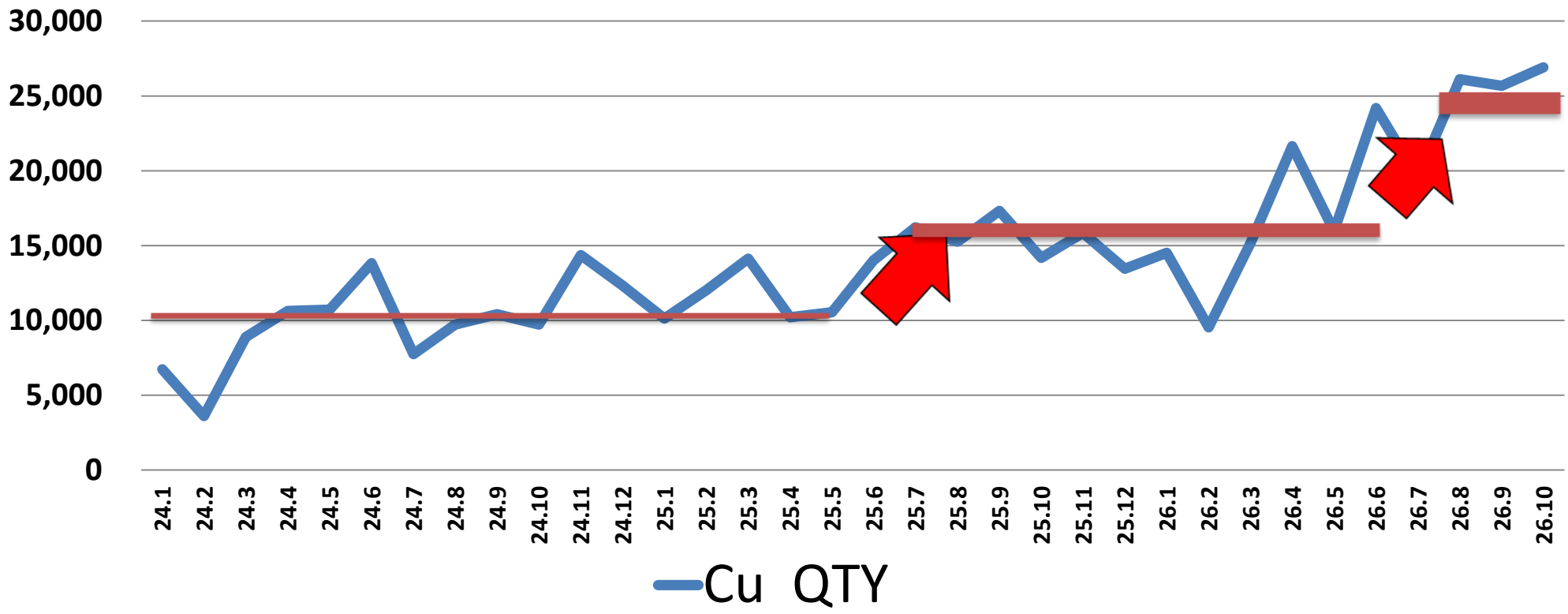
合計配發31.5元

（現金股利 25.1元+股票股利 6.4元）

交　貨　領　域

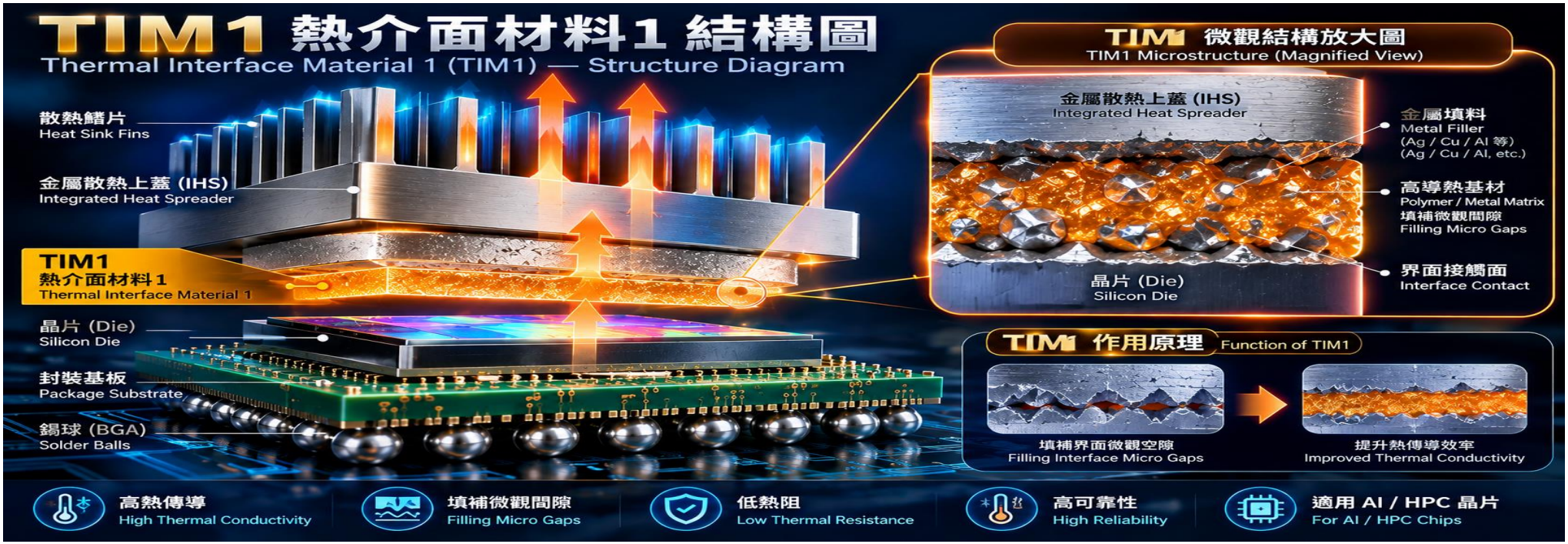

被動元件
電容、電感、電阻
銀漿、銅漿
鎳漿
A
B
IC \ LED 封裝
固晶
導電漿
太陽能
背銀
F
C
ROBOT 機器人
感測元件
PCB
盲孔填孔
E
D
AI 應用
先進封裝散熱
TGV
軟板高頻高速傳輸

MLCC銅膏出貨量 50%



下世代散熱 TIM1 半燒結膠

●TIM1(Thermal Interface Material)散熱材料用於先進封裝



	■ 熱傳導	■ 現況TIM1材料問題
■ 矽膠	■ 8 W/m.K	■ 模量低但熱傳不足
■ 石墨片	■ 20 W/m.K	■ 需增加接著劑黏接
■ 銅片	■ 80 W/m.K	■ 熱傳高但模量大
■ 半燒結膠	■ >80 W/m.K	■ 高熱傳 低模量 無孔隙

COPOS先進封裝 TGV

TGV (Through Glass Via) 在通孔玻璃基板上形成導電通道



TGV 技術變革 電鍍>>導電漿

anue 鉅亨

美股 > 國際政經

美股 玻璃基板技術大突破！半天工序縮至幾分鐘 拚明年量產

鉅亨網新聞中心 | 2026-10-07 15:10

AI新聞摘要

1. JNTC 玻璃基板 TGV 銅填充工序縮短至分鐘級，並解決空洞與銅面凹陷。
2. 美國主要半導體客戶驗證通過，業界推測為博通；台灣客戶也在測試。
3. JNTC 掌握玻璃芯完整製程，華城試產線月產能約1萬至1.2萬片，明年量產。

應用 @Robot



幫機器人穿「護甲」
陸電子皮膚訂單暴漲 估2030年破千億

大陸今年以來給人形機器人穿的「電子皮膚」訂單成長，專家估2030年能拿下千億新台幣商機。（新華社）

應用@PTFE


PTFE 基板含填孔示意圖
高頻・低損耗・高可靠度・適用於 5G/6G、雷達、衛星、車用高頻應用
低介電常數
(低損耗)
高頻高速
訊號傳輸
耐高溫
高可靠度
適用多元
高頻應用
銅箔（訊號層）
PTFE 基板
(低損耗・高頻)
銅箔（接地層）
多層結構示意
PTFE 填孔結構
以金屬導電漿填充 PTFE 板孔，形成可靠的電氣連接
填孔前
銅箔
層厚
鑽孔
(Via Hole)
PTFE 基板
PTFE
介電層
填孔後
可靠性
能參數
填孔漿料
分佈
金屬導電漿
填孔
可靠電氣連接
降低接觸電阻
提升高頻訊號完整性
高頻低損耗
維持 PTFE 優異
高頻特性
高可靠度
耐熱、耐環境
適用嚴苛應用
PTFE 基板填孔製程流程
① 鑽孔
雷射或機械鑽孔
形成 Via 孔
② 孔壁處理
進行等離子或化學處理
提升附著力
③ 塗佈導電漿
印刷或點膠方式
將金屬導電漿填入 Via 孔
④ 刮平 / 印刷
刮平表面
形成平整填孔
⑤ 乾燥 / 燒結
低溫固化或燒結
形成穩定導電結構
⑥ 完成
表面平整、可靠導通
適用於高頻高速應用

應用@半導體及LED封裝

導線架封裝示意圖

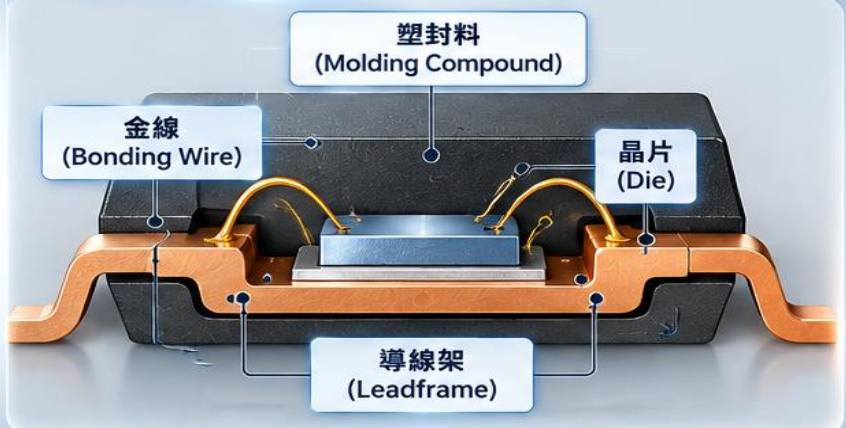
以導線架(Leadframe)為基礎的半導體封裝，實現體積小、散熱佳、高可靠度



主要應用

車用電子　消費電子　工業控制　電源管理

封裝結構剖面圖



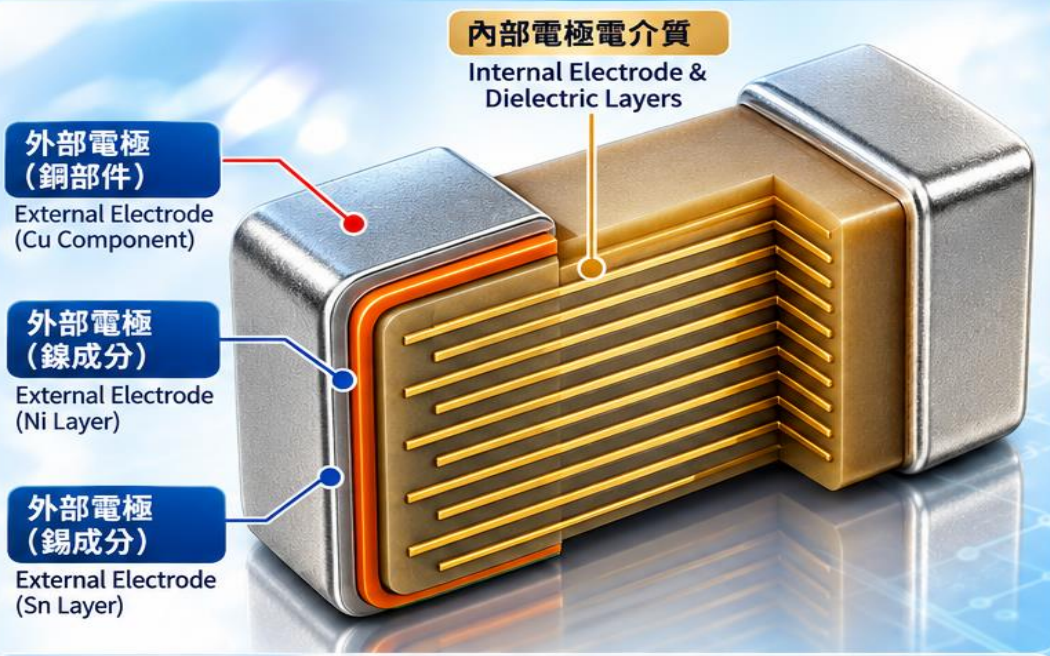
導線架封裝製程流程

1. 導線架沖壓成型 — 銅材沖壓形成導線架並進行表面處理
2. 晶片貼附 — 將晶片(Die)貼附於導線架上
3. 金線鍵合 — 以金線或銅線鍵合連接晶片與引腳
4. 塑封成型 — 注入塑封料(Molding)包覆晶片與金線
5. 後段加工 — 切除毛邊、電鍍、成型、外觀檢查
6. 完成產品 — 導線架封裝成品(SOP、TSSOP、QFN等)

導電漿是被動元件的血液

MLCC 多層陶瓷電容器
Multilayer Ceramic Capacitor

結構剖面圖 Structure (Cutaway View)



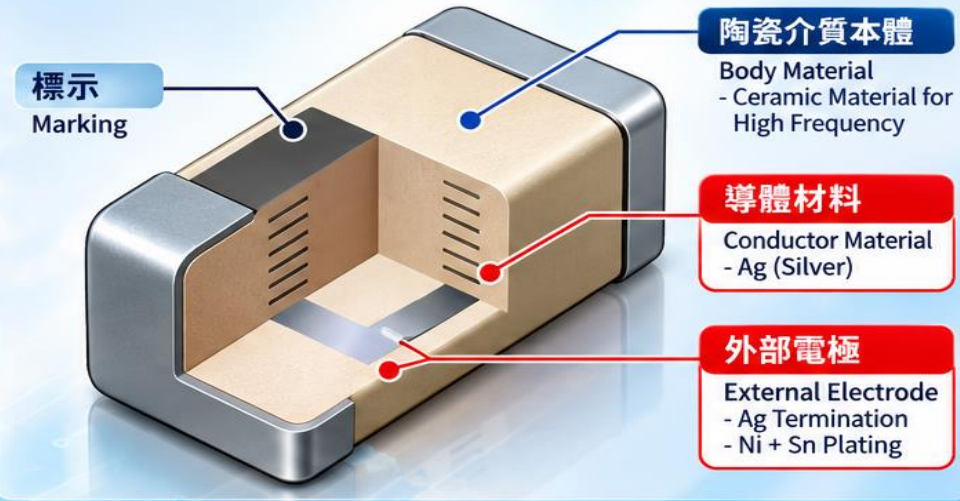


MLCC 簡介 Introduction

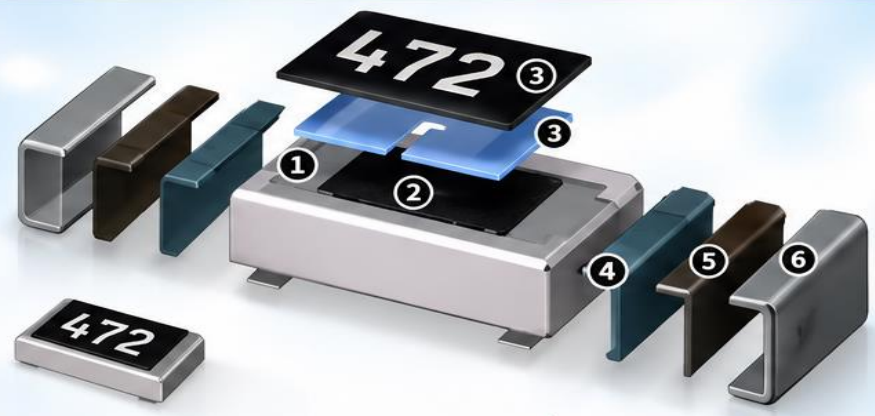
MLCC（多層陶瓷電容器）是利用陶瓷介質與內部金屬電極交替堆疊而成的微型電容器，具有小型化、大容量、高頻特性佳與高可靠度等優點，廣泛應用於手機、電腦、車用電子、伺服器及各類電子產品。

MLCC (Multilayer Ceramic Capacitor) is a chip capacitor composed of alternately stacked ceramic dielectric layers and internal metal electrodes, offering miniaturization, high capacitance, excellent high-frequency performance, and high reliability, and is widely used in mobile devices, computers, automotive electronics, servers, and various electronic products.

MLCI 晶片電感 Chip Inductor Structure (Example)



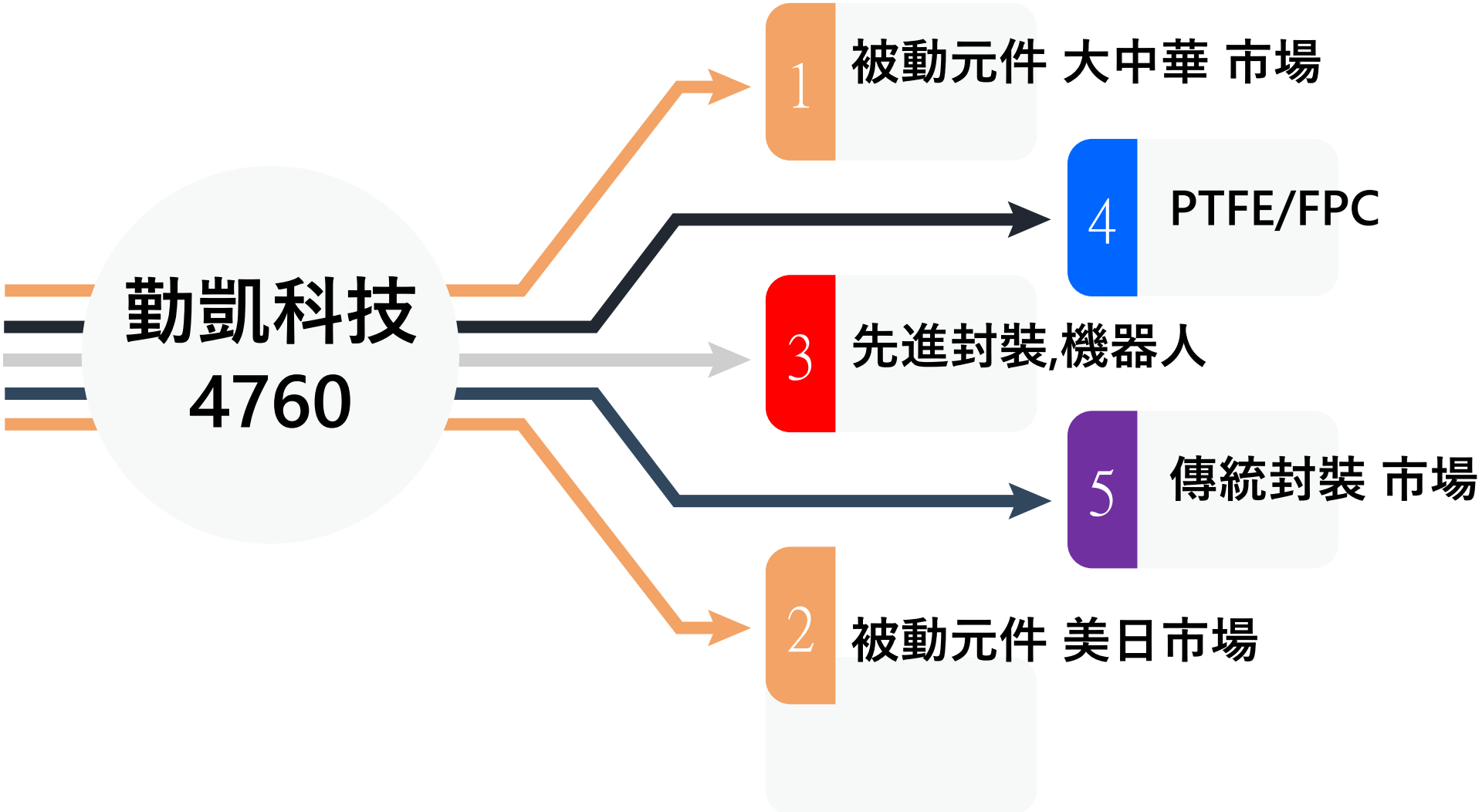
晶片電阻結構（相似製程） Chip Resistor Structure (Example)



2027-2028 成長項目



多點發酵


勤凱科技
4760
1
被動元件 大中華 市場
4
PTFE/FPC
3
先進封裝,機器人
5
傳統封裝 市場
2
被動元件 美日市場

感　謝　聆　聽

Q & A

Line :